

ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG

KONTAKT

Terry Emerson

terry.emerson@samtec.com

+1 812-981-8304

[SAMTEC LOGO]

January 2018

Neue Direktkartensteckverbinder von Samtec für mehr Geschwindigkeit und richtige Ausrichtung

Direktkartenverbinder im 0,8-mm- und 1,00-mm-Rastermaß mit
Edge Rate®-Hochgeschwindigkeitskontakten

New Albany, Indiana (USA): Samtec hat sein Angebot an Direktkartenverbindern um Buchsen im Rastermaß 0,8 mm und 1,0 mm erweitert, die für Anwendungen mit höheren Übertragungsraten und für die optimale Ausrichtung beim Steckvorgang konzipiert sind.

Die 0,8-mm-Raster-Buchsen aus der Baureihe [HSEC8-DP](#) sind eine Differential-Pair(DP)-Version der bekannten Edge Rate®-Buchsen von Samtec im 0,8-mm-Rastermaß. Die Buchse für Geschwindigkeiten bis 28 Gbit/s (NRZ) bzw. 56 Gbit/s (PAM4) ist mit Edge Rate®-Kontakten ausgestattet, die auf mehr Steckzyklen und weniger Übersprechen ausgelegt sind. Die doppelreihige Buchse mit insgesamt 8 bis 56 Paaren, optional mit robusten Lötbefestigungen, ist der Gegensteckverbinder zu Standardkarten mit einer Dicke von 1,60 mm (0,062").

Die für Geschwindigkeiten bis 28 Gbit/s optimierten Direktkartenstecker aus der Baureihe ([HSEC1](#)) sind ebenfalls mit Edge Rate®-Kontakten für hohe Datenraten versehen, optional mit Führungsstift oder robuster Lötbefestigungsglasche. Die Buchse ist mit insgesamt bis zu 140 Kontaktpositionen erhältlich und ist Gegensteckverbinder zu Standardkarten mit einer Dicke von 1,60 mm (0,062"). Bei bestimmten Anwendungen kann dieser Direktkartenverbinder dazu beitragen, Fehlausrichtungen in der X- und Y-Achse zu vermeiden und die optimale Kontakt-zu-Pad-Verbindung sicherzustellen.

Die glatte, breite und gefräste Kontaktfläche der [Edge Rate® Kontakte](#) reduziert die Auswirkungen des Broadside Couplings (Kopplungseffekte zwischen Leitungen mit parallelen ‚Breitseiten‘), was durch vermindertes Übersprechen zur besseren Signalintegrität beiträgt. Eine bessere Impedanzkontrolle wird durch einen geraden und gleichförmigeren Querschnitt des Materials erreicht. Dieses Kontaktsystem mit robusten Steck- und Trenneigenschaften überzeugt darüber hinaus mit einer langen Reibstrecke von bis zu 1,5 mm, wodurch sich die Winkeltoleranz beim Stecken erhöht. Des Weiteren eignen sich Edge Rate®-Kontakte für eine Vielzahl an Hochgeschwindigkeitsprotokolle und -standards.

„Die Samtec-Marke Edge Rate® ist in der Branche als vielseitige Lösung bekannt, die die Nutzung von Hochgeschwindigkeitssignalen bei höchster konstruktiver Sicherheit der Verbindung ermöglicht“, sagte Terry Emerson, der Projektmanager Micro Rugged bei Samtec. „Wir freuen uns, das Erfolgskonzept der Marke Edge Rate® durch die Erweiterung um diese beiden Produkte fortführen zu können.“

Samtecs Gesamtportfolio an [Leiterplattenrandverbindern für hohe Übertragungsraten](#) ist in einer Vielzahl an Rastermaßen und Ausführungen erhältlich. Die bekannten Edge Rate®-Buchsen aus der Baureihe [HSEC8](#) im 0,8-mm-Raster sind erhältlich in den Ausführungen Gerade, Durchsteckbar, Gewinkelt oder Randmontage sowie mit größeren Stapelhöhen bis 30 mm erhältlich. Eine Mini-Buchsenleiste mit 0,5 mm Kontaktabstand aus der Baureihe [MEC5](#) weist eine Ausgleichsfeder auf, die die Verwendung von Leiterplatten mit Standardtoleranzen ermöglicht und konform zu PCIe® Gen4 ist.

Zu den Standardausführungen der Hochgeschwindigkeits- Direktkartenverbinder gehören: 0,635 mm ([Reihe MEC6](#)), 0,80 mm ([Reihe MEC8](#)), 1,00 mm ([Reihe MEC1](#)), 1,27 mm ([Reihe MECF](#)) und 2,00 mm ([Reihe MEC2](#)). Die für Gen-4-Geschwindigkeiten geeignete PCIe-Buchse im 1,0-mm-Raster ([Reihe PCIE](#)) unterstützt eine, vier, acht und sechzehn Verbindungen (Lanes) und ist auch als besonders flache Version ([Reihe PCIE-LP](#)) erhältlich. Die Micro-Plane-Buchse im Rastermaß 1,0 mm ([Reihe SAL1](#)) ist konform zu SATALink™ und wird paarweise montiert, um verschieden dicke Steckkarten aufnehmen zu können.

Die [Signal Integrity Group](#) von Samtec leistet über die eigenen Signal-Integrity-Ingenieure Applikationssupport für diese Leiterplattenrandverbinder und viele weitere Produkte. Die hochqualifizierten Ingenieure unterstützen Sie mit Full-Channel-Analyse, Simulationen mit hohen Übertragungsraten, anwendungsspezifischer Entwurfs- und Entwicklungsunterstützung sowie modernstem Design-Support.

Weiterführende Information finden Sie auf der [Webseite mit den Randleistensteckverbindersystemen von Samtec](#).

Die Bildmarken PCI-SIG®, PCI Express® und PCIe® sind eingetragene Warenzeichen und/oder unregistrierte Dienstleistungsmarken der PCI-SIG.

Über Samtec, Inc.

Samtec, ein 1976 gegründetes Privatunternehmen, ist ein global agierender Hersteller von elektronischen Verbindungslösungen aller Art mit einem Jahresumsatz von \$713 Mio. Das Produktportfolio umfasst u. a. IC-zu-Board-Sockel und IC-Gehäuse,

Hochgeschwindigkeits-Board-zu-Board-Steckverbinder, Hochgeschwindigkeitskabel, Mid-Boards und optische Frontplattensteckverbinder, flexibles Stacking und Mikro-/besonders robuste Komponenten und Kabel. Samtecs Technologiezentren widmen sich der Entwicklung und Weiterentwicklung von Technologien, Strategien und Produkten, die sowohl die Leistungsfähigkeit als auch die Kosten eines Systems optimieren, vom nackten Chip bis zur 100 m entfernten Schnittstelle und allen dazwischen liegenden Verbindungspunkten. Mit 33 Niederlassungen in 18 Ländern ist Samtec weltweit präsent und kann dadurch einen einzigartigen Kundendienst bieten. Weitere Informationen finden Sie unter visit <http://www.samtec.com>.

Samtec, Inc.

P.O. Box 1147

New Albany, IN 47151-1147

USA

Telefon: 1-800-SAMTEC-9 (800-726-8329)

www.samtec.com